

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-03-016

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,689,546,322¹为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	陈小曼	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	
传真	0755-26613189	0755-26613189	
电话	0755-26634452	0755-26613445	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

¹因公司 2020 年 7 月 23 日发行“兴森转债”可转换公司债券，目前处于转股期，公司股本总数可能发生变动，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数。

2、报告期主要业务或产品简介

公司确立了“用芯联接数字世界”的全新品牌口号，坚持秉承“助力电子科技持续创新”的使命，为成为全球先进电子电路方案数字制造领军者而不断前行。

公司在 PCB 样板及批量板领域建立起强大的快速制造平台；在 IC 封装基板领域提供快速打样和量产制造服务；在半导体测试板领域打造业内领先的高层数、高厚径比、高平整度、小间距、高可靠性制造工艺能力和快速交付能力；并以印制电路板制造技术为基础，构建开放式技术服务平台，组建业内资深的技术顾问专家团队，形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力，结合配套的多品种快速贴装服务能力，为客户提供个性化的一站式服务。

报告期内，公司专注于印制电路板产业，围绕传统 PCB 业务和半导体业务两大主线开展。PCB 业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，推动客户满意度提升、大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦于 IC 封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）及半导体测试板，立足于芯片封装和测试环节的关键材料自主配套，一方面加速推动投资扩产的力度和节奏，实现从 CSP 封装基板到 FCBGA 封装基板领域的突破；另一方面加强与行业主流大客户的合作深度和广度。上述产品广泛应用于通信设备、服务器、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

公司日常生产以客户订单为基础，采用“以销定产”的经营模式，为客户研发、生产提供高效定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中：

PCB 业务采用 CAD 设计、制造、SMT 表面贴装和销售的一站式服务经营模式。

半导体业务包含 IC 封装基板和半导体测试板业务。IC 封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）采用设计、生产、销售的经营模式，应用领域涵盖存储芯片、应用处理器芯片、射频芯片、传感器芯片、CPU、GPU、FPGA、ASCI 等领域。半导体测试板提供设计、制造、表面贴装和销售的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程中，产品类型包括测试负载板、探针卡、老化板、转接板。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	11,888,295,338.85	8,302,218,319.33	43.19%	6,163,815,892.00
归属于上市公司股东的净资产	6,538,557,557.62	3,762,384,141.26	73.79%	3,289,281,863.27
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,353,854,994.29	5,039,987,053.24	6.23%	4,034,655,205.99
归属于上市公司股东的净利润	525,633,105.29	621,490,008.76	-15.42%	521,551,934.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,499,812.73	590,978,178.87	-33.08%	291,899,939.54
经营活动产生的现金流量净额	727,441,912.21	579,717,794.17	25.48%	407,672,002.49
基本每股收益（元/股）	0.33	0.42	-21.43%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.42	-21.43%	0.35
加权平均净资产收益	10.78%	17.73%	-6.95%	17.29%

率				
---	--	--	--	--

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,272,476,880.00	1,422,920,142.94	1,456,070,896.35	1,202,387,075.00
归属于上市公司股东的净利润	201,083,305.49	158,348,330.61	158,990,789.26	7,210,679.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,090,773.12	150,129,386.71	128,757,446.10	-4,477,793.20
经营活动产生的现金流量净额	118,784,432.65	92,919,726.65	213,101,501.54	302,636,251.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552.00	183,282,414.00	质押	95,684,822.00	
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828.00	0			
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996.00	0			
张丽冰	境内自然人	2.44%	41,150,322.00	5,040,322.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	29,508,288.00	0			
金宇星	境内自然人	1.15%	19,403,813.00	0			
UBS AG	境外法人	1.04%	17,650,786.00	17,439,516.00			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005LCT001 深	其他	1.01%	17,001,745.00	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.92%	15,604,245.00	10,080,645.00			
招商银行股份有限公司-交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	0.76%	12,829,151.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 19,311,452 股，通过普通证券账户持有公司股份 92,361 股，合计持有公司股份 19,403,813 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率 ²
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020年07月23日	2025年07月22日	26,853.41	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 兴森 01”、债券代码：112548）每张面值 100 元，发行总额 40,000 万元。“17 兴森 01”于 2022 年 7 月 19 日到期，公司已于 2022 年 7 月 19 日支付 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日期间的利息及本期债券本金并摘牌。 2、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券（可转债简称：兴森转债，可转债代码：128122），每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。公司已于 2022 年 7 月 25 日（因 2022 年 7 月 23 日为休息日而顺延）向本次付息的债权登记日 2022 年 7 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者派发利息，可转债票面利率 0.50%。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 14 日出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【243】号 01），公司 2020 年 7 月 23 日公开发行的可转换公司债券的 2022 年跟踪评级结果为：维持本期债券的信用等级为 AA，发行主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

²可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%。

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	40.87%	48.38%	-7.51%
扣除非经常性损益后净利润	39,549.98	59,097.82	-33.08%
EBITDA 全部债务比	30.10%	34.22%	-4.12%
利息保障倍数	6.00	10.54	-43.07%

三、重要事项

2022 年，供应链重构、俄乌战争等一系列黑天鹅事件，使得国内外政治经济环境面临前所未有的复杂动荡局面。行业层面，全球电子和半导体市场急转直下，整体景气度显著下行、需求低迷、竞争加剧。

报告期内，公司围绕既定的战略方向，全员聚焦、聚力、聚变，在坚守 PCB 产业链的同时，全面聚焦数字化转型，并毫不动摇的坚持高端封装基板业务的战略性投资。公司数字化转型初现成效，高端智能样板工厂在平均 6 天生产周期的基础上，交出了准交率 98%、良率超 97%的答卷，工厂经营效率进一步提升，为公司实现从兴森制造到兴森智造的战略转型奠定了理论和实践基础。下一步公司将在管理层面确立数字化转型的统一思想，以供应链领域“订单&计划数字化转型”项目在 PCB 广州事业部、PCB 宜兴事业部、BGA 事业部打造优秀样板为推动数字化转型落脚点。同时，组织分授权、全面预算管理、组织绩效优化、精益六西格玛项目、BCM 业务连续性管理等项目则持续深入推进。在重大项目投资层面，FCBGA 封装基板项目是公司实现技术、产品、客户升级的基础之所在，尽管面临行业景气波动的影响，但整体项目建设按照计划有序推进。珠海 FCBGA 封装基板项目从 2021 年 10 月启动筹建，历时 14 个月完成产线建设并试产成功，2023 年将全力开拓市场、导入量产客户；广州 FCBGA 封装基板项目从 2022 年 4 月 22 日动工，历时 5 个月完成厂房封顶，预计将于 2023 年第四季度完成产线建设，开始试产。

受限于行业层面需求不振、竞争加剧的压力，公司并未实现年初预定的经营目标，整体营收仅实现个位数增长，且净利润受费用拖累有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 535,385.50 万元、同比增长 6.23%；归属于上市公司股东的净利润 52,563.31 万元、同比下降 15.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,549.98 万元、同比下降 33.08%；总资产 1,188,829.53 万元、较上年末增长 43.19%；归属于上市公司股东的净资产 653,855.76 万元、较上年末增长 73.79%。2022 年，公司整体毛利率下降 3.51 个百分点；期间费用率增加 2.95 个百分点，其中，销售费用率下降 0.02 个百分点，管理费用率增加 1.18 个百分点，研发费用率增加 1.41 个百分点，财务费用率增加 0.38 个百分点。

报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

（一）PCB 业务平稳增长，盈利能力有所下滑

报告期内，PCB 行业面临需求不振和竞争加剧的双重压力，增长不达预期。公司 PCB 业务实现收入 403,017.45 万元、同比增长 6.22%，毛利率 30.29%、同比下降 2.84 个百分点。子公司宜兴硅谷在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破，全年实现收入 82,403.29 万元、同比增长 22.28%，净利润 2,555.69 万元、同比下降 59.58%，主要系批量板毛利率较低叠加产能利用率不足。Fineline 维持平稳增长，实现收入 151,115.93 万元、同比增长 17.21%，净利润 13,834.50 万元、同比增长 21.72%。英国 Exception 实现收入 6,191.83 万元、同比下降 8.22%，净利润 102.06 万元，同比下降 82.86%，主要系产线升级更新叠加成本上升。

（二）半导体业务持续聚焦 IC 封装基板业务的投资扩产

报告期内，公司半导体业务实现收入 114,897.08 万元、同比增长 6.05%，毛利率 17.25%、同比下降 6.79 个百分点。其中，IC 封装基板业务实现收入 68,954.21 万元、同比增长 3.45%；毛利率 14.75%、同比下降 11.60 个百分点。毛利率下降主要受新增产能拖累以及行业需求大幅下滑导致整体产能利用率下降影响，其中，广州兴科全年亏损 8,292.62 万元。FCBGA 封装基板项目仍处于建设阶段，未产生收入贡献，但整体人工成本、研发投入、试生产损耗等对公司利润形成较大拖累，FCBGA 封装基板项目全年费用投入约 10,200 万元。。

半导体测试板业务实现营收 45,942.87 万元、同比增长 10.21%，毛利率 21.00%、同比提升 0.66 个百分点，主要受益于广州基地半导体测试板工厂新产能贡献，交期和良率指标持续改善。其中，Harbor 实现营收 34,940.93 万元、同比下降 2.94%，净利润 1,328.75 万元、同比下降 65.28%，主要系新产品、新技术研发支出增多叠加成本上升影响。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：_____

邱醒亚

二〇二三年三月二十九日